平成 28 年 2 月 23 日

会 社 名　株式会社テラプローブ
代 表 者　代表取締役社長　渡辺 雄一郎
（コード番号：6627　東証マザーズ）

STMicroelectronics のスマートビルディング向けの最新デモセットに TeraFaces™ が採用

当社の顔認証ソフトウェア・ライブラリ TeraFaces™(以下、TeraFaces)が、STMicroelectronics*1(本社 スイス。以下、ST)のスマートビルディング向けの最新デモセットに採用されました。

当社の TeraFaces モジュールは ST 製 ARM® Cortex®-M4F マイクロコントローラ STM32F429 を採用しており、わずか 3cm 四方のモジュールで顔認証処理時間 0.3 秒以下の高速処理が可能です。
ST が展開するスマートビルディング向けの最新デモセットにおいて、入退場セキュリティ用途として TeraFaces モジュールのコンパクトかつ高速な処理が評価され、今般、採用に至りました。

このデモセットは、Mobile World Congress 2016(2016/2/22-25、バルセロナ)に出展されます。また、今後、ST の欧州・アジア・北米における展示およびプロモーションに活用される計画で、当社は各種展示会での説明員派遣や商談対応などに積極的に協力して参ります。

＜参考図：デモセット概観＞



TeraFaces に関する詳細は下記＜お問い合わせ先＞にご連絡ください。

＜お問い合わせ先＞

株式会社テラプローブ
Email: ml-atd-support@teraprobe.com

以上

※ Android は Google Inc.の商標または登録商標です。
※ ARM、CortexはARM Limitedの登録商標です。
※ TeraFacesは欧州においては“TeraPrhosopa”と呼称します。
*1 STMicroelectronics (URL: http://www.st.com)